

华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 TSV 及 2.5D 封装中试线提升改造项目（第一阶段：年中试生产 480 万颗 FCBGA 封装模块，其中月满产 687 片 TSV 或 3950 片 Bump）环境保护设施竣工日期和调试时间信息公开

根据《建设项目竣工环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第 682 号）、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评〔2017〕4 号）等文件相关规定，现将华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 TSV 及 2.5D 封装中试线提升改造项目（第一阶段：年中试生产 480 万颗 FCBGA 封装模块，其中月满产 687 片 TSV 或 3950 片 Bump）的环境保护设施竣工日期及调试日期进行公示如下：

项目名称：TSV 及 2.5D 封装中试线提升改造项目

建设单位：华进半导体封装先导技术研发中心有限公司

建设地址：无锡市新吴区景贤路 2 号

项目及配套建设的环境保护设施竣工日期：2025 年 7 月 8 日

调试日期：2025 年 7 月 10 日-2025 年 9 月 30 日

我公司承诺对上述公开的信息真实性负责，并承担由此产生的一切责任。

华进半导体封装先导技术研发中心有限公司

2025 年 7 月 10 日